

2023-2029年中国半导体封装用键合铜丝行业深度研究与市场运营趋势报告

报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制

www.chinairr.org

一、报告报价

《2023-2029年中国半导体封装用键合铜丝行业深度研究与市场运营趋势报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.chinairr.org/report/R06/R0601/202309/01-555041.html>

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: <http://www.chinairr.org>

Email: sales@chyxx.com

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

产业研究报告网发布的《2023-2029年中国半导体封装用键合铜丝行业深度研究与市场运营趋势报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。

第一章 概述

第一节 键合内引线材料

- 一、半导体的引线键合技术发展
- 二、引线键合技术（WB）
- 三、载带自动键合技术（TAB）
- 四、倒装焊技术（FC）

第二节 键合丝及作用

- 一、键合丝定义及作用
- 二、键合丝在IC封装中的作用

第三节 键合丝的主要品种

第四节 键合金丝的主要品种分类

- 一、按用途及性能划分
- 二、按照键合要求的弧度高低划分
- 三、按照键合不同封装形式划分
- 四、按照键合丝应用的不同弧长度划分

第二章 键合铜丝行业、市场的情况

第一节 国际半导体封装用键合丝行业发展概述

第二节 封装用键合丝行业的发展特点

第三节 国际键合丝的市场情况

- 一、键合铜丝市场发展历程
- 二、企业制造技术的发展推动了键合铜丝市场扩大及格局的改变
- 三、当前国际及我国键合丝行业面临的问题
- 四、国际键合铜丝的市场规模
- 五、国际键合铜丝的市场格局

第四节 我国键合铜丝的市场情况

- 一、我国整体键合丝市场需求量情况
- 二、我国键合铜丝市场需求量情况

第三章 键合铜丝的性能与国外技术发展

第一节 半导体封装工程对引线键合材料——键合丝的性能要求

- 一、引线键合在半导体封装制造中的应用
- 二、对半导体封装工程对引线键合材料——键合丝的性能要求
- 三、对键合铜丝的主要特性要求
 - (一) 对键合铜丝的物性要求
 - (二) 对键合铜丝的表面性能要求
 - (三) 对键合铜丝的线径要求

第二节 键合丝的主要采用的标准情况

- 一、国内外半导体键合用键合丝的主要标准
- 二、我国半导体键合用铜丝标准的编制情况

第三节 键合铜丝的特性

- 一、键合铜丝与其它键合丝主要性能对比
- 二、键合铜丝的成本优势
- 三、键合铜丝的性能优势

第四节 国外主要企业的键合铜丝产品品种及性能

- 一、国外键合铜丝产品发展概述
- 二、田中贵金属公司的四种产品
- 三、新日铁公司的覆PD键合铜丝
- 四、贺利氏公司的三种键合铜丝产品
- 五、MEK电子公司的三种键合铜丝产品

第四章 键合铜丝的制造工艺过程及产品知识产权情况

第一节 键合铜丝的制造工艺技术

- 一、键合铜丝的制造工艺流程简述
- 二、具体工艺的环节
 - (一) 坯料铸造
 - (二) 成丝加工

(三) 热处理

(四) 复绕(卷线)

第二节 键合铜丝制备过程及影响因素

第三节 键合铜丝的组织与微结构

第四节 键合铜丝知识产权情况

一、国际及我国键合铜丝专利情况

二、新日铁公司实施专利战略的情况

第五章 国际键合铜丝的主要生产企业现况

第一节 国际键合金丝的主要生产厂家概述

第二节 国际键合铜丝的主要生产厂家及其产品情况

一、田中贵金属株式会社

二、贺利氏集团

⋯⋯

第六章 我国国内键合铜丝的主要生产企业及其产品情况

第一节 概述

一、中国键合丝行业总况

二、中国键合丝生产及其企业分布情况

三、中国键合铜丝行业的生产情况

第二节 中国键合铜丝的主要生产厂家及其产品情况

一、贺利氏招远(常熟)电子材料有限公司

二、烟台招金励福贵金属股份有限公司

三、河南优克电子材料有限公司

⋯⋯

第三节 中国其它新建、在建的键合铜丝生产厂家情况

一、广州佳博金丝科技有限公司

⋯⋯

第七章 键合铜丝应用市场的现状与发展

第一节 国际半导体封测产业概况及市场

第二节 我国半导体封测产业发展及现况

- 一、中国IC封装测试业生产现况
- 二、我国国内分立器件生产企业情况

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R06/R0601/202309/01-555041.html>